平成 25 年 12 月 24 日
株式会社フジミインコーポレーテッド

TSMC 社より「Excellent Performance Award（優秀賞）」を受賞

当社は、世界最大の半導体ファウンドリー*である TSMC 社（本社 台湾・新竹市）より、2013 年 12 月 12 日同社主催のサプライチェーンマネジメントフォーラムにおいて「Excellent Performance Award」を受賞しました。

この受賞は、当社グループが提供する CMP**用研磨材の品質のみならず、その開発・製造・販売にいたる一連のサポートに対する卓越した品質を TSMC 社に高く評価いただいたものです。

当社にとって大切なお客様である TSMC 社より「Excellent Performance Award」を受賞でき大変光栄であり、当社はこれからも最高品質の製品及サービスを提供してまいります。

* ファウンドリー（受託製造）
半導体デバイスを受託生産する企業や工場。

** CMP
Chemical Mechanical Polishing（科学的機械的平坦化） の略。多層配線を精密に行うため、半導体チップ表面の凹凸を化学的機械的に磨き平坦化する技術。

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社フジミインコーポレーテッド
経営企画部
TEL 052-503-8183